(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年9月9日(09.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/083760 A1

(51) 国際特許分類7:

C23C 16/46, H01L 21/26

H01L 21/205,

INC.) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野三丁目 14番20号 Tokyo (JP).

NOZAKI, Kenji) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東

中野三丁目14番20号 株式会社日立国際電気内

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/003279

(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 篠崎 賢次 (SHI-

Tokyo (JP).

(22) 国際出願日:

2005年2月28日(28.02.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-056363

2004年3月1日(01.03.2004)

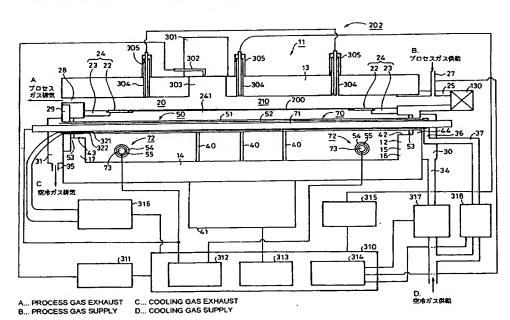
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式 会社日立国際電気 (HITACHI KOKUSAI ELECTRIC (74) 代理人: 宮本 治彦 (MIYAMOTO, Haruhiko); 〒 2280803 神奈川県相模原市相模大野三丁目19番 13号アーベイン相模ビル602号 Kanagawa (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

/続葉有/

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING EQUIPMENT AND SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 基板処理装置および半導体装置の製造方法



(57) Abstract: Semiconductor manufacturing equipment is provided with a process chamber for depositing a film on a substrate by flowing a gas, a lamp unit arranged in the process chamber to heat the substrate, a first surrounding body which surrounds the lamp unit, a second surrounding body which surrounds the first surrounding body, and a cooling medium communicating apparatus for communicating a cooling medium in a first space between the lamp unit and the first surrounding body and in a second space between the first surrounding body and the second surrounding body.

🔽 (57) 要約: ガスを流し、基板に膜を堆積させる処理室と、処理室に配置され、基板を加熱するランプユニットと、 ランプユニット囲う第1の囲い体と、第1の囲い体を囲う第2の囲い体と、ランプユニットと第1の囲い体との間 の第1の空間、および第1の囲い体と第2の囲い体との間の第2の空間に、冷却媒体をそれぞれ流通させる冷媒流 🔼 通装置とを備える。

WO 2005/083760 A1 HILLIAN HILL

ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。